

深圳市江波龙电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	Classica Capital、Bestinver、Millennium、Foord、BNP Paribas Exan
时间	2024年5月9日（周四）下午 17:45~18:45
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 许刚翎 证券事务代表 黄文芳

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>1、公司未来研发投入是否会继续保持高增长？</p> <p>答：公司从战略上实施从存储器厂商向半导体存储品牌公司的战略转型，为此未来将持续投入研发，优化产品结构及客户结构，通过自研主控芯片赋能公司成熟产品线，结合不断提升的自主封装测试产能，在产品上推陈出新。近年来，公司主要投入的多项研发项目已取得阶段性成果，短期来看公司的研发投入将持续增加，但增速或将放缓。</p> <p>2、目前下游客户的库存情况如何？</p> <p>答：自 2023 年三季度末开始，全球前五大存储晶圆原厂均开始采取持续减产措施，叠加手机、PC 等下游主要存储应用市场的逐步回暖，下游市场需求逐步复苏。由于终端市场细分领域众多，各下游厂商根据自身的需求进行备货，目前来看公司大客户的库存水位均保持在合理水平。</p> <p>3、目前中国消费者在智能终端领域的消费水平怎么样？</p> <p>答：自 2023 年三季度末开始，全球前五大存储晶圆原厂均开始采取持续减产措施，叠加手机、PC 等下游主要存储应用市场的逐步回暖，下游市场需求逐步复苏，半导体存储产业进入上行周期。展望 2024 年，在上游原厂减产力度维持以及下游需求逐步改善的基础上，半导体存储产业有望实现较为强劲的市场复苏。依据 WSTS 预测，2024 年全球市场规模将同比大幅增长 45%，达到 1298 亿美元，市场增长动能明显。</p> <p>4、公司业务受到宏观环境的影响有哪些？</p> <p>答：2023 年，受全球经济恢复放缓和通胀上升的影响，终端市场需求疲软，尤其是受到消费者支出影响的手机、PC 等重要市场需求低迷，导致半导体存储产品的需求下降。自 2022 年下半年开始，终端市场库存高企的压力向</p>
---------------------------	--

上传导至半导体存储产业链，导致存储芯片单位价格快速下降，并一直持续至 2023 年三季度。回顾 2023 年全年公司经营情况，1-9 月受本行业存储晶圆价格持续下跌，以及宏观经济环境复苏缓慢需求不振的双重影响，公司录得大额亏损。但是，在各种不利因素影响下，公司管理层及全体员工沉着应对，充分发挥自身在核心原料、核心技术、封测以及市场品牌方面的优势，采取各种措施大力拓展业务，在存储晶圆价格大幅下跌情况下，实现了出货量的大幅增加，并最终保证了前三季度营收与 2022 年同期基本持平。随着全球半导体存储市场受存储晶圆原厂减产以及下游需求逐步复苏的积极影响，行业于 2023 年三季度末开始步入上行周期，公司经营成效在四季度逐步体现。展望 2024 年，在上游原厂减产力度维持以及下游需求逐步改善的基础上，半导体存储产业有望实现较为强劲的市场复苏。在这一市场复苏的过程中，公司作为国内半导体存储领先企业，凭借前瞻的战略布局、深厚的技术积累以及敏锐的市场洞察力，将有望率先受益。

5、公司与西部数据等原厂的合作情况如何？

答：公司与上游主要存储晶圆原厂建立了长期、稳定和紧密的业务合作关系并签署了长期合约，确保存储晶圆供应的稳定性。其中，在与西部数据长期合作的基础上，双方将进一步深化业务合作，为大中华地区（包括中国大陆、港澳台地区）的手机市场提供市场领先的定制化嵌入式存储解决方案。通过双方的紧密合作，公司将能够更有效地利用西部数据的闪存技术优势，进而提升其在移动终端存储市场的产品竞争力，确保双方始终立足于嵌入式存储解决方案的创新前沿。

6、公司差异化竞争优势主要有哪些？

答：在核心技术方面，公司拓展了 SLC NAND Flash 等

	<p>小容量存储芯片设计能力，并推进相较于典型存储器/模组企业，公司研发布局突破藩篱进入到集成电路设计领域，实质性构建了自研 SLC NAND Flash 存储芯片设计业务，产品获得客户认可实现量产销售，代表着公司具备了从存储晶圆设计、生产端深入理解各类存储晶圆特性的能力。另一方面，公司已经推出了 eMMC 和 SD 卡主控芯片（已批量应用），并匹配自研固件算法的既有竞争力后，能够高效率满足客户，特别是大客户的产品性能要求，并且在售后服务故障解决等领域以自有能力帮助客户快速解决问题，从而最终建立起主营业务的进入壁垒，增加大客户黏性。</p> <p>封测制造方面，公司已在封装设计、测试算法及测试软件方面等储备了多年的实力，并于 2023 年完成了元成苏州和 Zilia 的并购，这是加强全球供应链布局，进一步开拓海外市场的重要举措，有助于公司形成全球化产能与国内产能兼顾、自主产能与委外产能并行的制造格局。</p> <p>在品牌优势方面，公司拥有行业类存储品牌 FORESEE 和国际高端消费类存储品牌 Lexar（雷克沙）。公司经过十多年的技术积累，打造了 FORESEE 品牌并在存储行业拥有良好的口碑；Lexar（雷克沙）是大陆地区为数不多的拥有高端消费类存储品牌的企业，在全球市场具有较高影响力。</p> <p>供应链方面，公司凭借应用技术、产品设计和市场销售优势，帮助晶圆原厂快速实现晶圆的产品化；其次，公司与国内外主要存储晶圆原厂签署了长期合约，确存储晶圆供应的稳定性，巩固公司在下游市场的供应优势。</p>
附件清单（如有）	无